

苏州国芯科技股份有限公司

2022年12月投资者关系活动记录表

证券简称：国芯科技

证券代码：688262

编号：2022-012

<p>投资者关系 活动类别</p>	<p> <input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研 <input type="checkbox"/>分析师会议 <input type="checkbox"/>媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/>业绩说明会 <input type="checkbox"/>新闻发布会 <input type="checkbox"/>路演活动 <input type="checkbox"/>现场参观 <input type="checkbox"/>其他（请文字说明其他活动内容） </p>
<p>参与单位名称</p>	<p> 嘉实基金；东方红资管；华夏基金；海富通基金；汇添富基金；交银施罗德基金；中邮基金；国泰君安证券；平安基金；盘京投资；宝盈基金；德邦证券；君子兰；西部证券；富国基金；安信证券；长盛基金；中信建投证券；国泰基金；银华基金；交银基金；中加基金；长信基金；丰琰投资；东方证券；兴银理财；中信建投资管部；深圳多鑫；中荷人寿；德邦证券；厦门金恒宇；Prudence Investment Management (Hong Kong) Ltd.（方圆投资管理（香港）有限公司）；西藏合众易晟；杭州巨子；百年保险；景泰利丰；易米基金；富善投资；溪牛投资；上海银叶；厦门中略；海南进化论私募；中信保诚；方正证券；青骊投资；民生加银；云南能投资本；上海拾贝能信；上海磐稳；Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.（元大证券投资信托股份有限公司）；盈峰资本；中信建投基金；上海光大；海金（大连）；泰康资产；上海迎水投资；上海瓴仁；浙商证券；上海泰旻；先锋基金；陕西抱朴；海南拓璞；中银金融；上投摩根基金；凯石基金；敦和资产；创金合信；中国国际；平安资产；安徽明泽；海南拓璞；上海斯米克；Cephei Capital Management (Hong Kong) Limited；招银理财；北京诚盛；上海磐稳；中科沃土；上海海通；万和证券；浙江永禧；上海弘尚；上海宁泉；贝莱德；国泰基金；金信基金；中国国际；深圳市明达；惠升基金；东方证券自营；太平基金；多鑫投资；百年保险；淳厚基金；东吴基金；华泰柏瑞；中金基金；域秀资产；广银理财；安信资管；前海开源；泰旻资产；银华基金；中信资管；多鑫投资；建信养老；银华基金；南方基金；生命资产；上银基金；申万菱信；星石投资；红土创新；上海和谐汇一；泰康资产；前海人寿；中银基金；华宝基金；聚鸣投资；东方基金；南方基金；北大方正人寿；西部利得基金；天虫资本；汐泰投资；易米基金；东吴基金；信达澳亚；国源信达；中泰自营；洋京资本；海通证券；拾贝投资；翀云资产；季胜投资；凯石基金；鹏扬基金； </p>

	昭图投资；彤源投资；翀云私募；国泰基金；中略投资；肇万资产；国寿安保基金；西部利得基金；方圆集团；中海基金；盈峰资本；上海明河；金元证券；寻常投资；混沌投资；国海证券；西南证券；敦和资管；兴业证券；星石投资；建信理财；森锦投资；龙赢资产；中金资管；同犇投资；阳光保险；留仁资产；建信信托；誉辉资本；九泰基金；雷根基金；招商基金；泓澄投资；鑫元基金；九泰基金；千禧投资；相聚资本；中国平安金融；东兴资管；工银安盛资管；深圳红筹；上海尚雅；富荣基金；华融证券；上海森锦；长城财富；华龙证券；鹏扬基金；汐泰投资；沅京资本；寻常投资；蜂巢基金；众安在线财险；源峰基金；新华资产；华美投资；永赢基金；天治基金；中荷人寿；汇华理财。
时间	2022年12月2日15:00 2022年12月2日16:30 2022年12月6日13:30 2022年12月6日15:30 2022年12月7日9:45 2022年12月7日13:00 2022年12月8日15:00 2022年12月9日10:00 2022年12月9日13:00 2022年12月13日10:00 2022年12月15日14:00 2022年12月16日14:00 2022年12月27日9:00 2022年12月27日16:00 2022年12月28日14:00 2022年12月30日15:00
地点	线上交流及现场交流
上市公司参加人员姓名	董事长：郑荭先生 总经理：肖佐楠先生 独立董事：张薇女士

	<p>董事会秘书：黄涛先生</p> <p>财务总监：张海滨先生</p> <p>证券事务代表：龚小刚先生</p>
<p>投资者关系 活动主要内 容介绍</p>	<p>投资者就其关心的问题，向公司提出了问题，公司参会人员进行了回复，主要情况如下：</p> <p>1、领导您好，能否介绍一下公司前三季度的业绩情况，谢谢</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！截至 2022 年 9 月 30 日，公司的营收达到 3.22 亿元人民币，同比增长 21.78%；归属上市股东的净利润达到 9,664.76 万元人民币，同比增长 163.98%；扣非后净利润达 3,737.45 万元人民币，与上年同期相比 49.14%。谢谢！</p> <p>2、公司在汽车电子上的布局怎么样？最新进展如何？</p> <p>答：在汽车电子芯片领域，公司的芯片产品线覆盖面较全，已在多个方向上实现产品系列化，继续与埃泰克汽车电子（芜湖）有限公司、科世达（上海）管理有限公司和潍柴动力集团等一批汽车电子领域头部客户保持良好的合作关系，汽车电子车身控制芯片和动力总成控制芯片采用和国内头部车身控制模组厂商、发动机厂商协同创新的合作方式，在产品开发阶段就受到国内汽车整机厂商和 Tier1 汽车电子模组厂商的关注和订单支持，形成公司汽车电子芯片产品的先发优势，并获得了市场的认可和良好的业界口碑，公司致力于成为国内汽车电子芯片的领先供应商。2022 年 10 月，国芯科技建设的“江苏省汽车电子芯片工程研究中心”被认定为 2022 年江苏省工程研究中心。</p> <p>（1）汽车车身控制芯片领域：公司于 2022 年上半年推出的 CCFC2012BC 中高端车身及网关控制芯片，可对标国外产品如 NXP（恩智浦）MPC5604BC、MPC5607B 系列以及 ST（意法半导体）的 SPC560B50、SPC560B64 系列，受到市场的普遍欢迎，订单增加较快，客户包括多家 Tier1 模组厂商和国内主要的汽车品牌厂商，该芯片采用自主可控的 PowerPC 的指令集。截至 2022 年 9 月底，公司研发成功的新一代中高端车身/网关控制芯片已经实现超过 130 万颗出货和装车，应用场景包括整车控制、车身网关、安全气囊、无钥匙启动及 T-BOX 等应用，可实现对国外产品的替代，覆盖新能源车和传统乘用车等；目前下游的涵盖整车客户包括比亚迪、上汽、长安、奇瑞、东风等，预计随着公司产品前装应用增加和影响力增加，芯片的订单及出货增长量会进一步增加。</p> <p>（2）汽车动力总成控制领域：公司已研发成功 CCFC2003PT、CCFC2006PT 等型号芯片产品，其中 CCFC2003PT 对标 NXP（恩智浦）MPC5634、CCFC2006PT 对标 NXP（恩智浦）</p>

MPC5554, 并已在重型发动机中获得实际应用, 对标 NXP (恩智浦) MPC5674 的 CCFC2007PT 已经内部测试成功, 对标 NXP (恩智浦) MPC5777 的 CCFC3007PT 芯片产品正在设计中, 可覆盖传统的汽柴油发动机、新型混动发动机及电动机应用需求。动力总成控制芯片需要更长的时间进行应用验证, 公司目前正在和相关厂商紧密合作, 争取尽快实现产业化规模应用。目前国内能开展汽车动力总成控制芯片研发的厂商还很少, 公司在国内处于领先地位。公司构建了和汽车发动机领域头部客户和动力总成控制模组头部厂商为主的战略合作关系格局, 共同定义新产品, 实现国产化替代。汽车发动机芯片技术难度大, 但市场急需国产化。

2022 年 8 月 31 日, 公司发布公告披露了公司成功研发的 CCFC2007PT 芯片产品, 是基于公司自主 PowerPC 架构 C*Core CPU 内核研发的新一代汽车电子动力总成及新能源电池管理 (BMS) 控制芯片, 是在已有 CCFC2006PT 芯片基础上根据客户需求对功能的进一步增强和完善。该芯片基于 40nm eflash 工艺开发和生产。CCFC2007PT 芯片按照汽车电子 Grade1 等级进行设计和生产, 具有高可靠性, 可以应用于苛刻的使用场景, 从而增加了产品的应用覆盖面, 封装形式包括 BGA516/BGA324/LQFP216/LQFP144 等, 可以广泛应用于汽、柴油车动力总成和新能源电池管理。

(3) 汽车域控制器领域: 公司已经完成汽车域控制器芯片 CCFC2016BC 的研发和流片, 该芯片产品已经内测成功, 目前已实现市场销售应用。该芯片的产品定义过程中充分征求了国内头部新能源汽车厂商的意见。同时, 我们也正在研发高端的域控制芯片 CCFC3007PT、CCFC3008PT 和 CCFC3009PT 芯片系列。

(4) 新能源电池 BMS 控制领域: 2022 年 8 月 31 日, 公司公告披露了公司成功研发的 CCFC2007PT 芯片产品可以应用于新能源电池管理 (BMS) 控制芯片, 目前公司正在和国内新能源电池厂商一起合作推动应用方案开发, 争取尽快实现规模化应用。公司正在开展新一代高性能新能源电池管理控制芯片 CCFC3008PT 的研发, 进展顺利。

(5) 车规级安全 MCU 芯片: 公司已成功开发 CCM3310S-T、CCM3310S-H 和 CCM3320S 等三款汽车电子安全芯片产品, 形成高、中、低产品系列, 其中 CCM3310S-T/CCM3310S-H 已批量供货, CCM3320S 已完成客户验证和实现小批量应用, 主要对标国际领先厂商有恩智浦和英飞凌相关产品, 主要应用包括车载 T-BOX 安全单元、车载诊断系统 (OBD) 安全单元、车联网 C-V2X 通信安全应用等。CCM3310S-T、CCM3310S-H 车规级芯片已获颁国内首批汽车安全芯片可信安全认证证书, 经中国汽车技术研究中心有限公司软件测评 (天

津)有限公司测试, CCM3310S-T、CCM3310S-H 车规级芯片满足 ACS-EAL5+等级要求, 达到目前国内安全芯片在汽车行业专业安全认证方面的最高等级。

在其他应用领域, 公司也开始瞄准汽车电子混合信号类以及专用 SoC 芯片领域国产化替代机会, 启动汽车门控混合信号芯片 CCL1100B 的研发以及安全气囊点火芯片、新能源汽车降噪芯片等的研发工作。

3、截至 9 月 30 日, 公司前三季度汽车电子芯片的出货量怎么样?

答: 尊敬的投资者, 您好! 公司前三季度汽车电子芯片的出货量已经超过 130 万颗。今年的汽车电子芯片出货主要以车身控制芯片为主, 预计明年会有更多的出货量, 会有更多型号的汽车电子芯片产品进入市场。谢谢!

4、现在信创大家关注比较高, 请问一下你们公司信创领域的业务现在发展怎么样?

答: 尊敬的投资者, 您好! 公司信创领域的产品主要包括云应用芯片和端应用芯片。云应用芯片包括云安全芯片、存储控制 Raid 芯片和边缘计算芯片, 具体包括:

(1) 云安全芯片产品, 主要面向服务器、VPN 网关、防火墙、路由器、密码机、智能驾驶路测设备、视频监控、电力隔离设备、可信计算和 4G/5G 基站等领域, 公司云安全芯片性能优异, 具有国际先进水平。目前正在根据原有产品 CCP903T/CCP907T 用户使用反馈, 在 PCIE 控制器升级、安全算法性能的提升、总线频率的提升、SEC 安全引擎增强、IPSEC 特定应用场景下的硬件加速、支持不同应用场景下的功耗控制优化等方面进行改进。公司云安全芯片和模组已进入国家颁布的信创目录, 获得国密型号产品证书, 可以在信创领域推广应用。在信创检测项目中, 公司云安全芯片和模组已和鲲鹏、龙芯、飞腾和兆芯等国产 CPU 芯片主板都完成过适配。

(2) RAID 控制器芯片, 主要面向服务器应用, 可以为客户提供灵活可靠、大容量存储资源管理, 基于公司自主 C*Core CPU 内核 C8000 研发的一款磁盘阵列控制芯片, 具备多个独立的接口通道支持连接最多 40 个机械硬盘或 SSD 固态存储盘, 兼容 PCIE 标准开发, 实现数据的高可靠、高效率存储及传输管理, 具有全面的 RAID 数据保护机制, 提供 RAID0/1/5/6/10/50/60 模式, 实现阵列管理软件功能。该产品已完成样品开发, 目前正在进行规模化量产设计, 于 2022 年底左右进行量产投产。

(3) 边缘计算、安全和网络通信集成处理控制器芯片, 主要用于边缘计算和通用嵌入式计算中的综合控制、安全处理、数据通路、应用层处理和微服务器主控, 正在研发的多款新产品采用国芯 32 位或 64 位四核的 PowerPC 指令架构 CPU 核, 集成高性能密码

算法引擎和网络数据加速引擎，具有千兆网、万兆网、PCIe3.0、USB3.0、RapidIO2.0等高速接口。

在信创领域，除以上云应用芯片外，还包括公司的多种端应用芯片，公司的端应用芯片产品具有身份认证、数字签名、数据加解密及可信计算等功能，多款产品通过相关部门安全认证，已应用于信创 PC、打印机和电子钥匙等领域。谢谢！

5、公司现在业务发展较好，那么请问你们公司的产能是否有保障呢？

答：公司与相关供应商有良好合作和积极沟通，能及时解决生产环节遇到的各种问题，我们产能有保障。

6、请问公司未来重点发展的业务方向是什么？

答：公司未来的规划是进一步加大汽车电子芯片、信创和信息安全芯片等两大领域的销售收入占比，立足自主 CPU 技术，进一步开发高性能的 SoC 芯片系列，在汽车 MCU 芯片、RAID 芯片、云安全芯片等方面在国内保持领先地位。。

7、公司的边缘计算业务发展怎么样？

答：随着物联网、5G 等技术的飞速发展，可穿戴设备、移动智能终端、智能网联汽车和机器人等设备产生海量的数据，并且普遍要求数据处理的低时延和高可靠性，云计算集中式的大数据处理模式有时候不能完全满足需求，在某些领域边缘计算的运行效率可能更高。边缘计算使数据能够在最近端进行处理，减少云、端间的数据传输，极大提升效率，很适合高交互、大带宽的 5G 时代。此外，在对数据采集和传输日益敏感的环境下，边缘计算本地化处理数据为企业安全合规带来很大便利。

公司边缘计算芯片目前首先针对信创领域应用进行布局，主要包括：

(1) 高性能边缘计算、安全和网络通信集成处理控制器芯片 H2040，基于 28nm 工艺设计，采用国芯 32 位四核的 PowerPC 指令架构 CPU 核，集成 DDR3.0、PCIe3.0、千兆网、SATA2.0、RapidIO2.0 等接口，已完成流片，芯片内部测试成功，主要用于边缘计算和通用嵌入式计算中的综合控制、安全处理、数据通路和应用层处理。(2) 新一代高性能边缘计算、安全和网络通信集成处理控制芯片 S1020，基于 14nm 工艺设计，采用国芯 64 位多核 PowerPC 架构 CPU 核，集成高性能密码算法引擎、网络数据加速引擎、高性能 RAID 算法引擎等，具有万兆网、PCIe3.0、USB3.0 等高速接口，可实现对国外产品如 NXP 的 T2040 系列相应产品的替代，主要用于边缘计算、网关、VPN、微服务器等设备的主控芯片。该产品已完成设计和流片，目前正在内部测试中。

附件清单 (如有)	无
日期	2022年12月